



社長メッセージ

1



市場動向に合わせた
経費管理の徹底と共に、
中長期的な生産体制の増強や
先端技術への対応に注力していきます。

事業環境・業績

2012年度上期の世界経済では、欧米諸国の景気低迷が続き、中国をはじめとする新興国経済に減速感が生じるなど、先行きは不透明な状況にありました。一方、半導体業界においては、スマートフォンやタブレット端末などの新製品発表が相次ぎ、メーカ各社は生産設備の投資活動を活性化させました。このような事業環境において当社は積極的な販売活動を行った結果、アジア地域のOSAT(後工程受託メーカ)向けを中心に、ほぼ全ての製品群にて好調な出荷となったことから、売上高は半期ベースでは過去2番目の水準となりました。営業利益は、円高や販売管理費の増加が影響したものの、特にレーザーソーやハイスペックグライндаなどの高付加価値製品の売上が伸長したため、前年同期に対して増益となりました。

取り組みと見通し

2012年度下期ではマクロ経済が調整局面入りし、半導体メーカ各社にて生産計画を見直す動きが見られます。また、スマートフォンやタブレット端末に関連する投資が一巡した影響もあり、当社の下期売上高は、上期と比べ約2割減となる見込みです。当社はこれに伴った経費管理の引き締めを行う一方で、多様化する顧客ニーズに対応すべく研究開発活動を今後も継続して行っていきます。お客さまからの引き合いが多かった上期では、各々に異なる特殊仕様の設計や製品の短納期出荷などで多忙を極めましたが、比較的落ち着いた見通しとなる下期では、次の好況時に“刈り入れ”ができるよう、新製品設計やアプリケーション開発などに注力していきます。特に先端技術分野においては、半導体製造の後工程プロセスにて難易度の高い技術ニーズが増える傾向にあります。お客さまがこれらの技術を用いた製品量産を行う際には、

当社の製品が必ず選ばれるよう今のうちから準備を進めてまいります。

また、中長期的には世界の半導体市場は今後も拡大することが見込まれるため、設備稼働率が高水準な状態にある当社桑畑工場において、免震構造を持つ新棟建設の決定をいたしました。これにより、生産体制の増強とBCM※対応力の向上を実現し、今後の急峻な需要の増加などに柔軟に対応できる体制を整えます。

今後の事業運営においては、無駄な経費支出を抑えつつ、戦略的に研究開発活動を推進させ、顧客ニーズの取り込みに注力してまいります。株主の皆様におかれましては一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

※BCM(Business Continuity Management: 事業継続管理)

2012年12月

代表取締役社長 関家一馬

カッティングエッジ

CUTTING EDGE

74期中間事業のご報告

2012年4月1日～2012年9月30日



DISCO

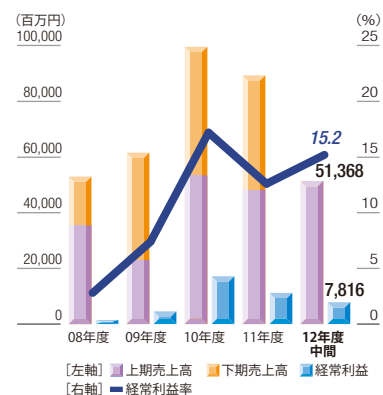
Kiru・Kezuru・Migaku Technologies



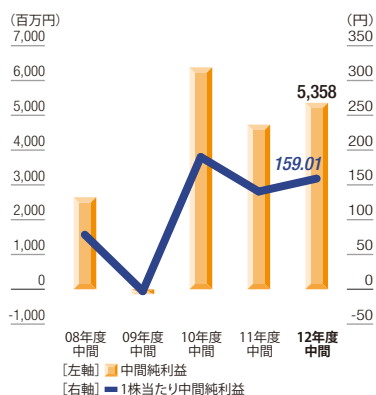
財務ハイライト

2

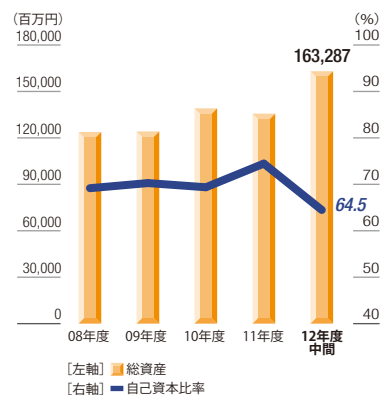
売上高・経常利益・経常利益率



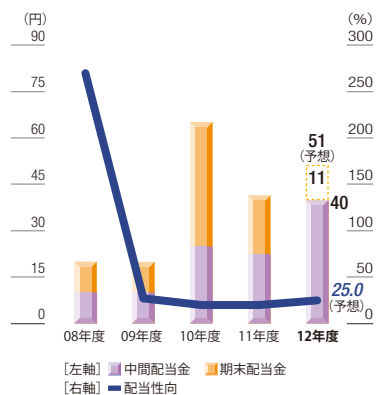
中間純利益・1株当たり中間純利益



総資産・自己資本比率



配当金・配当性向



当期の概況

当中間期(2012年4月1日から2012年9月30日まで)は、半導体業界・電子部品業界でモバイル機器に用いる半導体・電子部品の需要が拡大しました。このような中、精密切断装置では、主にIC向けの出荷が堅調に推移し、なかでもレーザーソーはLow-K※1向けやDAF※2カット向けなど用途の広がりを見せました。精密研削・研磨装置では、アプリケーションの多様化に伴いハイエンド機を中心に出荷が伸びました。消耗品である精密加工ツールでは出荷が堅調に推移したことから、その売上高は為替の影響を受けたものの半期としては過去最高となりました。

その結果、当中間期の売上高は半期としては過去最高(2010年度上期:534億5百万円)に次ぐ高い水準となりました。損益では、積極的な研究開発活動や販売手数料の増加などにより、販売管理費が前年同期に対し大きく増加しました。その一方で、売上高増加や製品構成の変化に伴ったGP率上昇により、営業利益率はほぼ同水準となりました。

以上の結果、当中間期の業績は売上高513億68百万円(前年同期比6.1%増)、営業利益74億94百万円(同8.6%増)、経常利益78億16百万円(同9.9%増)、中間純利益53億58百万円(同13.3%増)となりました。

※1 Low-K…高速処理を行うICに用いられる、とても脆い材料
 ※2 DAF…Die Attach Filmの略。チップを実装・積層するのに用いる特殊粘着フィルム

■財政状態について

当中間期末の総資産は、前期末と比較して274億97百万円増加して1,632億87百万円となりました。これは、工場新棟の建設を目的とした銀行借入などにより現預金が増加したほか、売掛金やたな卸資産なども増加したためです。負債は、支払債務や未払法人税の増加、銀

行借入による借入金の増加などにより前期末と比べ230億80百万円増加し563億33百万円となりました。純資産は、利益剰余金が前期末より47億18百万円増加したことなどにより、1,069億54百万円となりました。

これらの結果、自己資本比率は、前期末比10.0ポイント減となる64.5%となりました。

■配当について

2012年5月10日開催の取締役会にて配当方針を一部変更しています。

当社は業績に連動した配当を実施することを基本方針とし、中間期末・期末の年2回に、連結半期純利益の25%を配当いたします。また、利益水準に関わらず安定配当として半期10円(年間20円)を維持いたします。ただし、3期連続で連結純損失の場合を除きます。

当中間期末の配当につきましては、配当政策に基づき、1株当たり40円とさせていただきます。

通期の連結業績予想

現在、スマートフォン関連の設備投資が一服し、先端技術への戦略的投資を行うメーカーの一部でも設備投資を手控えています。このような事業環境の変化を受け、2013年3月期の業績見通しを修正いたします。下期の想定為替レートは1ドル78円とし、通期では前年度に対し増収減益を見込んでいます。

2013年3月期

(金額の単位:百万円)

売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
91,500	10,000	10,600	6,800	201.77円

CLOSE UP! 効率的な生産と安定的な製品供給の維持確保のために

3

精密加工装置・精密加工ツールの製造を行う桑畑工場(広島県)において約110億円を投資し、免震構造の新棟(仮称:桑畑工場B棟)建設を決定しました



名称	桑畑工場B棟(仮称)
着工日	2013年7月
竣工日	2014年10月
建屋構造	免震構造
延べ床面積	約60,000m ² (A棟は約55,000m ²)
投資総額	約110億円

建屋の左部分が新棟部分。既存棟(A棟)と各階で連結させ、外観上では一つの建屋となる予定。

新棟建設の目的

《需要拡大へ対応するための生産体制増強》

桑畑工場A棟(既存棟)では、2011年11月に製品に必要な主要部品を製造する部門を移入したこともあり、近年の稼働状況は非常に高い水準で推移しています。このような状況のもと、今後の更なる需要増加に備えるために、生産体制の増強を行います。

《BCM対応力の向上》

精密加工ツールの一部は、リスク分散の観点から桑畑工場の旧棟(非免震構造)にて製造*していましたが、これらの機能を免震構造の新棟に集約させることで、BCM対応力の向上を図ります。

*精密加工ツールの大半は広島県呉市にある呉工場にて製造

→ 新棟竣工により、全ての精密加工ツール・精密加工装置が免震構造棟にて生産できる体制となります

効率的な生産に向けた取り組み

《移動距離を最小に抑えた生産現場》

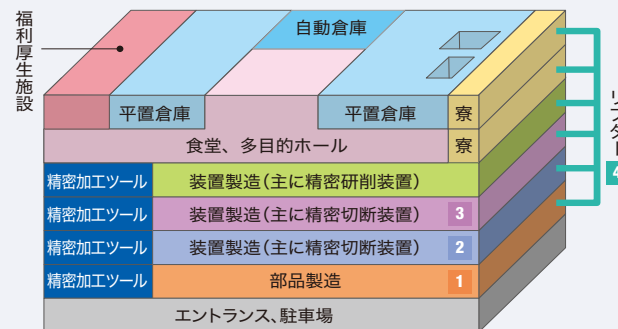
レイアウトの工夫などにより、精密加工装置の生産は効率的に行われます

【製品組み立てまでの流れ】

- ① 製品を構成する大半の部品は、社外より納品され、まず最上階の自動倉庫へ格納されます
- ② スピンドル(加工軸)などの主要部品は、最下階にて大型工作機械を用いて製造されます
- ③ 中間階では上下階より必要な部品の供給を受けて、製品の組み立てを行います

-
- ひとつの建物内で生産システムが完結します
 - 上下への移動はリフターを用い、製品の着工から完成までの移動距離を最小に抑えます

桑畑新棟フロアレイアウトイメージ図



部品の階間移動に用いるリフター



主要部品の製造に必要な大型の工作機械

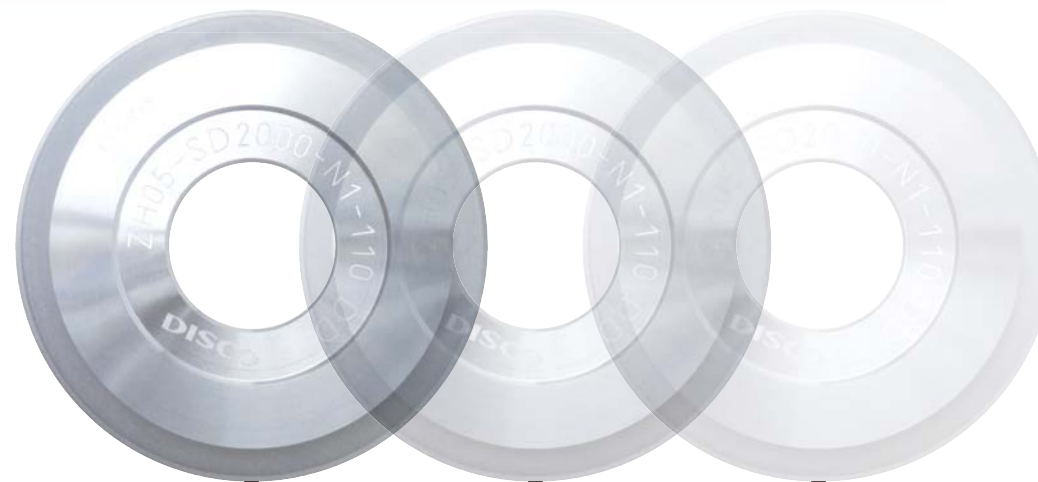


出庫された部品を組立現場まで運ぶ専用の台車



必要な部材が手元に揃う組立現場

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって 遠い科学を身近な快適につなぐ」



3つのコア技術を深めることで、ディスコは産業と暮らしに貢献していきます。

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」とは

ディスコのビジネステーマを指しています。人類に欠かせない普遍的な技術である「切る」「削る」「磨く」という事業領域において、ディスコは世界のオンリーワン企業でありたいと考えています。あえてローマ字で表記しているのは、これらの分野でディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという、強い思いが込められているからです。

「遠い科学を身近な快適につなぐ」とは

ディスコの社会的使命(ミッション)を意味しています。日々進歩していく科学技術を、ディスコの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」によって、人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたい、という考えを表現しています。

ディスコが追い求める成長とは

企業の成長をどのように定義するかによって、経営の方向性は大きく変わります。ディスコの「成長」とは売上やシェア、規模の拡大などに依らず、2つの基準によって評定されています。ひとつはミッションの実現度が高まり、社会により大きく貢献ができてきているか、もうひとつはお客様・従業員・サプライヤ・株主など、すべてのステークホルダとの価値交換性が向上しているか、です。